

# 深圳市德明利技术股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	易方达基金、博时基金、永赢基金、长江证券、国信证券、中金公司
时间	2025年2月20日
地点	深圳市福田区新一代产业园1栋A座24楼公司办公室
上市公司接待人员	李虎、于海燕、彭震
形式	线下及线上交流
交流内容及具体问答记录	<p><b>1. 问：介绍一下公司目前企业级存储产品和市场拓展情况，未来三年企业级存储业务业绩指引是什么样的？</b></p> <p>答：企业级存储主要应用于服务器、数据中心、云计算等场景，对产品性能和供应链管理要求较高，具体包括可靠性、稳定性、安全性、兼容性等。基于此，公司通过组建专业、成熟的企业级业务和研发团队，配套完善的企业级存储产品测试线，结合多年积累的供应链资源，快速形成可靠产品与全周期存储管理方案，高效推动客户验证工作。</p> <p>2024年，公司持续与多家互联网厂商、服务器厂商、云服务厂商接洽，开展产品验证工作。公司产品目前已经通过了多家客户验证，进入其供应链体系，并实现了小规模销售。AI应用不断加速，AI大模型训练与推理带来的存储需求有望持续增长，国家政策推动、信息安全重视度提升，均有利于国产企业级存储市场规模增长。公司将持续加大研发创新，聚焦自主可控，持续推动公司企业级存储业务发展。</p> <p><b>2. 问：除了企业级存储产品，公司在AI方面是否有其他布局？</b></p> <p>答：AI技术的发展对存储产品提出了更高要求，公司积极布局，研发了适用于AI设备的大容量、高性能存储解决方案。</p> <p><b>3. 问：公司嵌入式存储产品增长较快，主要原因是什么，后续展望如何？</b></p>

答：上市以来，公司持续在嵌入式存储业务发力，持续推动包括团队组建、产品研发、客户拓展等工作。嵌入式存储因在实际应用场景中产品生命周期较长、客户替换成本高，导致下游前期验证要求严格、时间周期长。公司通过组建优秀嵌入式团队，针对客户定制化需求，提供全流程技术支持，推出了 eMMC、UFS、LPDDR 等产品，经过长期技术攻关，已完成主流客户认证导入，实现批量出货。公司未来将延续“技术-客户”双轮驱动，持续拓展嵌入式产品矩阵，将前期验证壁垒转化为长期竞争壁垒，推动嵌入式存储成为业绩新增长点。

**4. 问：公司是否有车规级的产品，主要包括哪些？**

答：车规级存储市场是公司重点拓展的方向之一，随着智能汽车的快速发展，对存储设备的需求不断增加。公司已研发出符合车规级标准的存储产品，具备高可靠性、高耐久性和宽温域等特点，能够满足汽车在各种复杂环境下的数据存储需求。目前，正在与多家汽车制造商和 Tier1 供应商进行合作洽谈，部分产品已进入样品测试阶段，车规级移动存储产品已有小批量出货，未来有望实现更多车规级存储产品的销售。

**5. 问：公司对于目前存储价格情况怎么看，如何看 25 年价格走势？**

答：存储行业具有明显的周期性，供需情况直接影响现货价格。2024 年全年存储整体价格先升后降，近期基本保持稳定，同时也存在结构性分化的情况，高性能企业级存储维持高位，消费级市场因需求波动呈现震荡态势。从公开报道可以看到，自 2024 年底以来，已有上游多家存储原厂宣布了产能调整计划。展望未来，随着下游库存消耗，叠加包括大模型技术创新、AI 端侧应用加速、智能驾驶渗透率提升带来的存储需求增长，有望持续改善存储供需，进而延续行业上行周期。

**6. 问：公司后续库存策略是怎么样的？**

答：公司库存整体保持中性策略，供应链交付中心根据前端业务反馈，结合市场价格制定采购计划，提升库存周转。同时，公司也在积极优化库存结构，针对目前产品矩阵和终端客户不断拓展，各类新品持续放量情况，公司适当增加了包括优质闪存颗粒、内存颗粒的采购，保障新客户、新业务、新产品的良好发展势头。

	<p><b>7. 问：公司智能制造（福田）存储产品产业基地目前情况如何，企业级存储产品测试线是否已经正式启用？</b></p> <p>答：公司智能制造（福田）存储产品产业基地已经竣工启用，并顺利通过了智能制造成熟度（CMMM）三级评估，以及 QC080000 体系与 BSCI 认证，已形成了全业务链数字化运营管理集成体系，打造了高度灵活且柔性化生产设备矩阵，基地配套建有专业性能测试、失效分析、材料、可靠性、电磁兼容、安全和仿真等实验室。</p> <p>企业级存储产品需要满足高可靠性、低延迟、长寿命及极端环境稳定性的严苛要求。为确保产品复杂工况下的性能一致性和低故障率，公司在业务规划阶段即前瞻布局测试线建设工作，目前该测试线首期建设工作已完成并正式启用，有望提升企业级 SSD 产品开发与客户验证效率。</p> <p><b>8. 问：公司存储主控芯片进展情况，其他在研主控芯片整体时间规划如何？</b></p> <p>答：公司闪存模组以自研主控芯片为核心，随着研发实力不断增强，芯片研发不断拓展提速。公司新一代自研 SD6.0 存储卡主控芯片成功量产，产品适配工作进展顺利，目前已有各类搭载该款主控的存储卡模组送样，待客户验证通过后即可实现批量导入；SATA SSD 主控芯片已经成功量产，正在加快产品适配与测试，目前整体工作进展顺利。公司已经立项 PCIe SSD、UFS、eMMC 主控芯片项目，未来将持续推动研发工作，持续提升在功耗优化、传输速率、存储容量及纠错能力等关键技术领域的创新突破。</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>